

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-037

芯联集成电路制造股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第六次会议于2025年7月1日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年6月26日向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席王永生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

监事会认为：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会注册申请在全固银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具对公司经营发展的实质需要，有利于优化公司融资结构，提高资金运用的灵活性，不存在损害公司及股东利益的情况。

综上，监事会一致同意本议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯联集成电路制造股份有限公司关于拟申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》(公告编号:2025-036)。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会

2025年7月3日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-036

芯联集成电路制造股份有限公司 关于拟申请注册发行银行间债券市场 非金融企业债务融资工具的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和完整性依法承担法律责任。

为满足芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展资金需求、调整优化公司债务结构、降低财务费用，为公司高质量发展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程规定，结合公司经营实际情况和债券市场现状，公司于2025年7月1日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币40亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，品种包括中期票据、超短期融资券(以下简称“本次发行”)。具体如下：

一、发行方案主要条款

(一)发行品种及规模
本次发行规模不超过人民币40亿元，其中，中期票据不超过人民币25亿元，超短期融资券不超过人民币15亿元。具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

(二)发行期限
中期票据发行期限不超过5年(含5年)，超短期融资券发行期限不超过270天(含270天)。具体期限根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

(三)票面金额和发行价格
债券面值为人民币100元，按面值平价发行。

(四)发行利率
根据债券融资工具发行期间市场利率情况，通过集中簿记建档方式确定。

(五)综合融资成本
发行综合成本包括票面成本和发行承销费。具体发行成本根据公司发行时市场情况确定。

(六)其他相关费用
本次发行及承销费用由法律顾问机构、会计师事务所、资信评级公司等中介机构而产生的相关费用。

(七)募集资金用途
本次募集资金将用于偿还公司债务、补充流动资金和项目建设等合法合规用途，具体资金用途以交易商协会批复为准。

(八)发行方式
公司将根据实际情况在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

(九)发行对象
本次发行面向合格专业投资者发行(国家法律法规禁止的购买者除外)。

(十)承销方式
主承销商包销余额包销方式承销。

(十一)担保安排
本次发行的债券为无担保债券。

(十二)回售条款
本次发行是否设置回售条款及相关条款具体内容，根据发行时的市场情况确定。

(十三)偿债保障措施
发行人对债券的第一还款责任人，确保公司财务状况良好，以自身现金流确保正常还款，

保障债务融资工具本息正常兑付。

(十四)决议有效期
本次发行经公司股东大会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效。

二、本次注册发行的授权事项

为合规、高效、有序完成本次发行工作，根据《公司法》等法律法规及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权总经理全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(一)在法律法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行的具体方案及发行条款，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行成本、发行方式、承销方式、担保方式、回购条件、偿债保障措施、募集资金用途等与本次发行相关的具体事宜；

(二)聘请承销商、资信评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次发行申报事宜；

(三)签署与本次注册发行有关的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行的相关信息披露文件；

(四)办理与本次注册发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次发行的注册登记手续、发行及交割等事项的有关手续；

(五)在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关部门意见进行调整、修订；

(六)办理与本次发行有关的其他事项。

授权期限自本次发行事项经公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审批程序

公司于2025年7月1日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，报交易商协会批准后方可实施，存在一定的不确定性，最终方案以交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次债务融资工具相关进展情况。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会

2025年7月3日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-038

芯联集成电路制造股份有限公司 关于拟申请注册发行银行间债券市场 非金融企业债务融资工具的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和完整性依法承担法律责任。

为满足芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展资金需求、调整优化公司债务结构、降低财务费用，为公司高质量发展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程规定，结合公司经营实际情况和债券市场现状，公司于2025年7月1日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币40亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，品种包括中期票据、超短期融资券(以下简称“本次发行”)。具体如下：

一、发行方案主要条款

(一)发行品种及规模
本次发行规模不超过人民币40亿元，其中，中期票据不超过人民币25亿元，超短期融资券不超过人民币15亿元。具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

(二)发行期限
中期票据发行期限不超过5年(含5年)，超短期融资券发行期限不超过270天(含270天)。具体期限根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

(三)票面金额和发行价格
债券面值为人民币100元，按面值平价发行。

(四)发行利率
根据债券融资工具发行期间市场利率情况，通过集中簿记建档方式确定。

(五)综合融资成本
发行综合成本包括票面成本和发行承销费。具体发行成本根据公司发行时市场情况确定。

(六)其他相关费用
本次发行及承销费用由法律顾问机构、会计师事务所、资信评级公司等中介机构而产生的相关费用。

(七)募集资金用途
本次募集资金将用于偿还公司债务、补充流动资金和项目建设等合法合规用途，具体资金用途以交易商协会批复为准。

(八)发行方式
公司将根据实际情况在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

(九)发行对象
本次发行面向合格专业投资者发行(国家法律法规禁止的购买者除外)。

(十)承销方式
主承销商包销余额包销方式承销。

(十一)担保安排
本次发行的债券为无担保债券。

(十二)回售条款
本次发行是否设置回售条款及相关条款具体内容，根据发行时的市场情况确定。

(十三)偿债保障措施
发行人对债券的第一还款责任人，确保公司财务状况良好，以自身现金流确保正常还款，

保障债务融资工具本息正常兑付。

(十四)决议有效期
本次发行经公司股东大会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效。

二、本次注册发行的授权事项

为合规、高效、有序完成本次发行工作，根据《公司法》等法律法规及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权总经理全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(一)在法律法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行的具体方案及发行条款，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行成本、发行方式、承销方式、担保方式、回购条件、偿债保障措施、募集资金用途等与本次发行相关的具体事宜；

(二)聘请承销商、资信评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次发行申报事宜；

(三)签署与本次注册发行有关的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行的相关信息披露文件；

(四)办理与本次注册发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次发行的注册登记手续、发行及交割等事项的有关手续；

(五)在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关部门意见进行调整、修订；

(六)办理与本次发行有关的其他事项。

授权期限自本次发行事项经公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审批程序

公司于2025年7月3日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，报交易商协会批准后方可实施，存在一定的不确定性，最终方案以交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次债务融资工具相关进展情况。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会

2025年7月3日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-039

芯联集成电路制造股份有限公司 关于拟申请注册发行银行间债券市场 非金融企业债务融资工具的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和完整性依法承担法律责任。

为满足芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展资金需求、调整优化公司债务结构、降低财务费用，为公司高质量发展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程规定，结合公司经营实际情况和债券市场现状，公司于2025年7月1日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币40亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，品种包括中期票据、超短期融资券(以下简称“本次发行”)。具体如下：

一、发行方案主要条款

(一)发行品种及规模
本次发行规模不超过人民币40亿元，其中，中期票据不超过人民币25亿元，超短期融资券不超过人民币15亿元。具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

(二)发行期限
中期票据发行期限不超过5年(含5年)，超短期融资券发行期限不超过270天(含270天)。具体期限根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

(三)票面金额和发行价格
债券面值为人民币100元，按面值平价发行。

(四)发行利率
根据债券融资工具发行期间市场利率情况，通过集中簿记建档方式确定。

(五)综合融资成本
发行综合成本包括票面成本和发行承销费。具体发行成本根据公司发行时市场情况确定。

(六)其他相关费用
本次发行及承销费用由法律顾问机构、会计师事务所、资信评级公司等中介机构而产生的相关费用。

(七)募集资金用途
本次募集资金将用于偿还公司债务、补充流动资金和项目建设等合法合规用途，具体资金用途以交易商协会批复为准。

(八)发行方式
公司将根据实际情况在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

(九)发行对象
本次发行面向合格专业投资者发行(国家法律法规禁止的购买者除外)。

(十)承销方式
主承销商包销余额包销方式承销。

(十一)担保安排
本次发行的债券为无担保债券。

(十二)回售条款
本次发行是否设置回售条款及相关条款具体内容，根据发行时的市场情况确定。

(十三)偿债保障措施
发行人对债券的第一还款责任人，确保公司财务状况良好，以自身现金流确保正常还款，

保障债务融资工具本息正常兑付。

(十四)决议有效期
本次发行经公司股东大会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效。

二、本次注册发行的授权事项

为合规、高效、有序完成本次发行工作，根据《公司法》等法律法规及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权总经理全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(一)在法律法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行的具体方案及发行条款，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行成本、发行方式、承销方式、担保方式、回购条件、偿债保障措施、募集资金用途等与本次发行相关的具体事宜；

(二)聘请承销商、资信评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次发行申报事宜；

(三)签署与本次注册发行有关的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行的相关信息披露文件；

(四)办理与本次注册发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次发行的注册登记手续、发行及交割等事项的有关手续；

(五)在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关部门意见进行调整、修订；

(六)办理与本次发行有关的其他事项。

授权期限自本次发行事项经公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审批程序

公司于2025年7月3日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，报交易商协会批准后方可实施，存在一定的不确定性，最终方案以交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次债务融资工具相关进展情况。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会

2025年7月3日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-040

芯联集成电路制造股份有限公司 关于拟申请注册发行银行间债券市场 非金融企业债务融资工具的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和完整性依法承担法律责任。